

環球晶圓(6488 TT) 2021年第1季營運報告

5 月, 2021



Disclaimer

This presentation has been prepared by GlobalWafers Co., Ltd. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.

Parts of this presentation summarize advice from external US and EU counsel and are therefore subject to attorney work product and attorney-client legal professional privilege



經營團隊重點報告

➤ 2021

- 營收 - 無懼逆風，逐季成長
- 毛利率及EPS - 今年獲利較低的因素如下：
 - ✓ 美國暴風雪
 - ✓ 日本大地震
 - ✓ 蘇伊士運河阻塞使運費上漲
 - ✓ 貨櫃艙位短缺導致緊急調度的運輸成本
 - ✓ 多項原物料成本上漲

➤ 股利政策

- 在全面評估營運以及籌資策略後，環球晶圓董事會通過決議，將策略性調降我們往年高於產業平均之股利發放率，並掌握這段景氣上揚期間，將資金最有效地用於業務發展並實現最佳的財務結構。
- 2020 現金股利 – 共計新台幣18元 (2020年上半年度：新台幣 8 元 + 2020年下半年度：新台幣 10 元)
- 2020 現金股利發放率 – 60% (2020年上半年度：55% + 2020年下半年度：64%)

➤ Siltronic收購案進度更新

- 取得韓國公平會核准
(迄今，已取得德國、奧地利、韓國的反壟斷機關核准，並取得美國CFIUS批准)

1. 2020 dividend payout is subject to AGM approval on June 22, 2021



➤ 籌資計畫

- 擬發行不超過新台幣220億元國內無擔保普通公司債，作為中長期資金，主要用以償還債務
- 擬發行總額上限為美金10億元海外無擔保可轉換公司債用以原幣購料之資金需求
- 擬於普通股不超過5千萬股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，以因應併購及/或策略聯盟發展及/或充實營運資金及/或償還銀行借款及/或轉投資及/或資本支出，提請股東會核議授權

➤ 產業概況

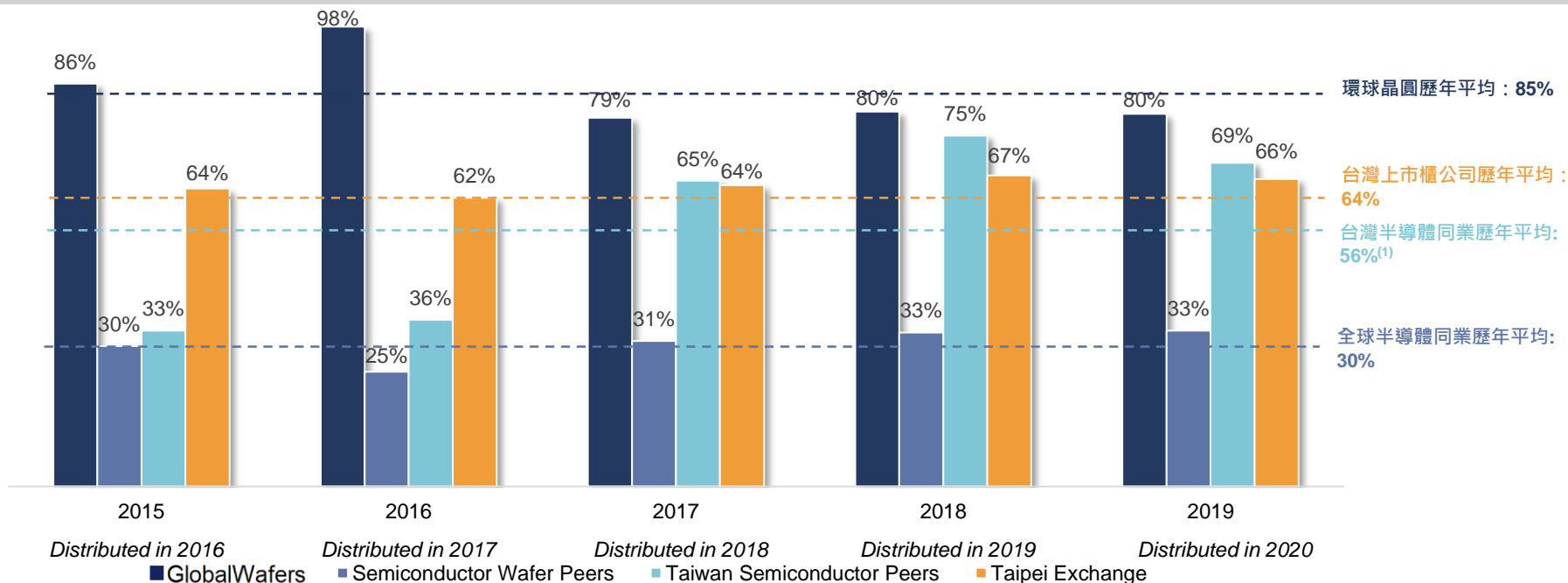
- 在各國政府推出財務紓困政策及預期疫苗施打將於2021下半年帶來經濟復甦，國際貨幣基金組織IMF預測2021年全球GDP成長率有望達到6%
- 2021年第一季半導體晶圓出貨量達到史上最高，刷新之前2018年第三季的歷史最高記錄
所有尺寸的晶圓出貨量皆增加
- 5G- 5G系統整合商與電信商合作關係持續深化，將會擴大5G的滲透率
- 車用半導體- 自動駕駛技術及聯網汽車預期將為車用半導體創造新一波商機



環球晶圓高股利配發歷史

- ▶ 環球晶圓過去皆維持較高的股利政策，不僅較同業高出許多，同時也高於台灣半導體同業平均及上市櫃公司平均。
- ▶ 透過策略性調降往年高於產業平均之股利發放率，環球晶圓可值此景氣上揚之際將現金投資於製程改善、製程能力提升，以追求未來營運成長，並回饋股東豐碩營運成果及永續的股利。

歷年股利發放率



Source: CapitalIQ, FactSet.

Note: 全球半導體同業包括信越、Sumco與Siltronic; 台灣半導體同業包括台勝科、合晶與嘉晶。

1. 未包括嘉晶2019股利配發數字約 625% (2019 每股股利 NTD0.25, EPS 0.04) · 原因為2019年稅後淨利遽降

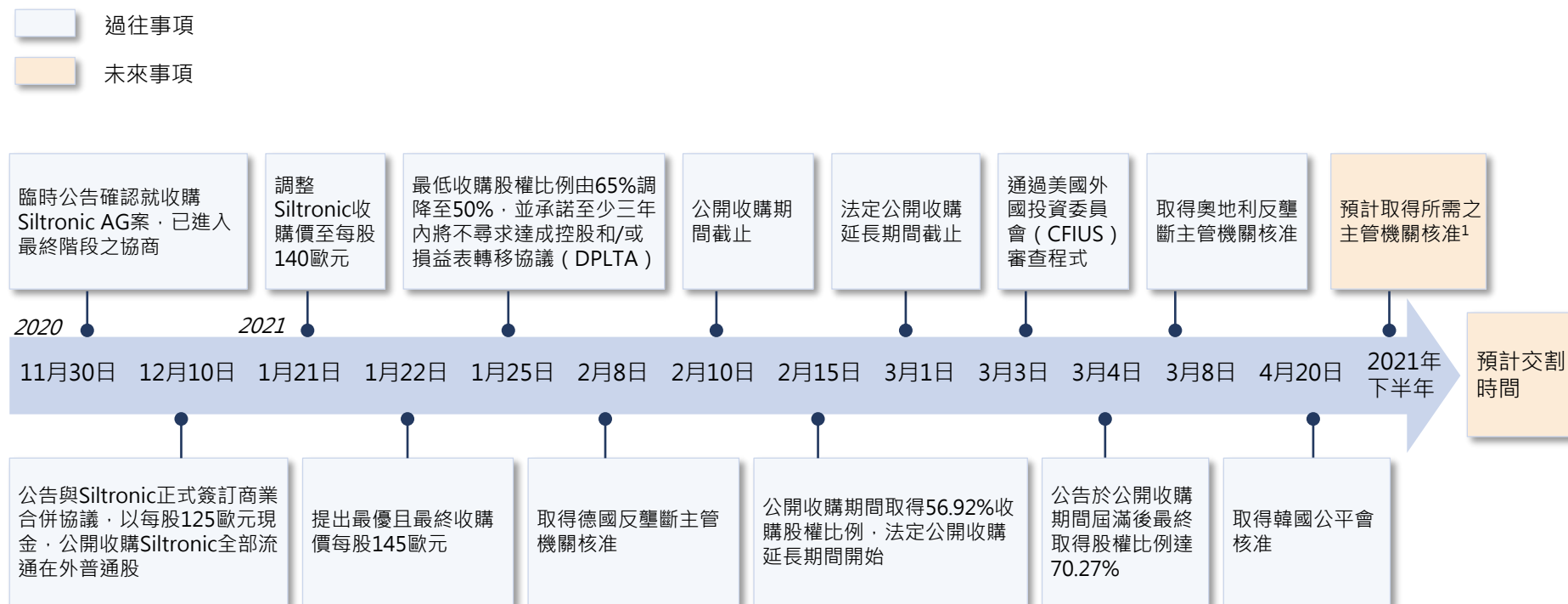


關於Siltronic併購案



Siltronic收購案主要發展

- 環球晶圓最終取得70.27%收購股權比例
- 收購Siltronic一案目前仍需取得相關主管機關核准，預計將於2021年下半年完成



1. 需獲得美國、中國、臺灣、日本、新加坡反壟斷核准；以及德國及英國（若需要）之外國投資主管機關（投審會）核准。



籌資計畫



籌資計畫

➤ 預期將強化環球晶圓之財務結構以及資本分配能力

● 已公布的籌資計畫

- ✓ 擬發行不超過新台幣220億元國內無擔保普通公司債，作為中長期資金，主要用以償還債務
- ✓ 擬發行總額上限為美金10億元海外無擔保可轉換公司債用以原幣購料之資金需求
- ✓ 擬於普通股不超過5千萬股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，以因應併購及/或策略聯盟發展及/或充實營運資金及/或償還銀行借款及/或轉投資及/或資本支出，提請股東會核議授權

● 原因及優勢

- ✓ 適時掌握目前有利於公司之資本市場，取得對公司有利的籌資發行條件，進行債務與股權組合之籌資活動，同時考量：
 - 維持債務與股權平衡且最佳的財務結構，故較不受世界經濟局勢變盪及目前新冠疫情所影響
 - 不會過度稀釋股本、影響股東權益
 - 在產業前景正面的環境下（如前季法說提及）能加速獲利成長
- ✓ 強化環球晶圓之資本分配能力以準備迎接未來的營運成長

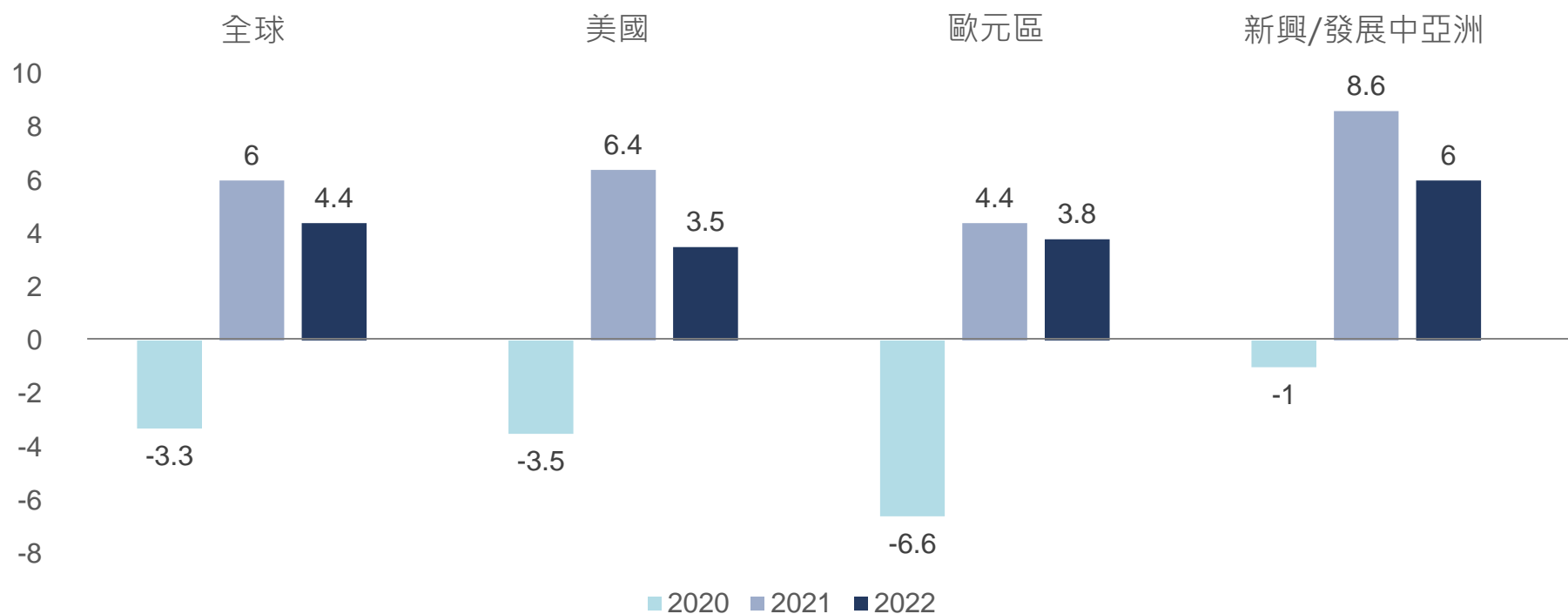


產業概況

全球GDP成長率預測

- 國際貨幣基金組織 (IMF) 上修之前預估的2020年全球GDP成長率至衰退3.3%，亦上調2021年全球GDP成長率為6%。
- IMF 認為「這場疫情的影響將會是漫長、崎嶇且具有高度不確定性」。

全球經濟展望 (2021.04)



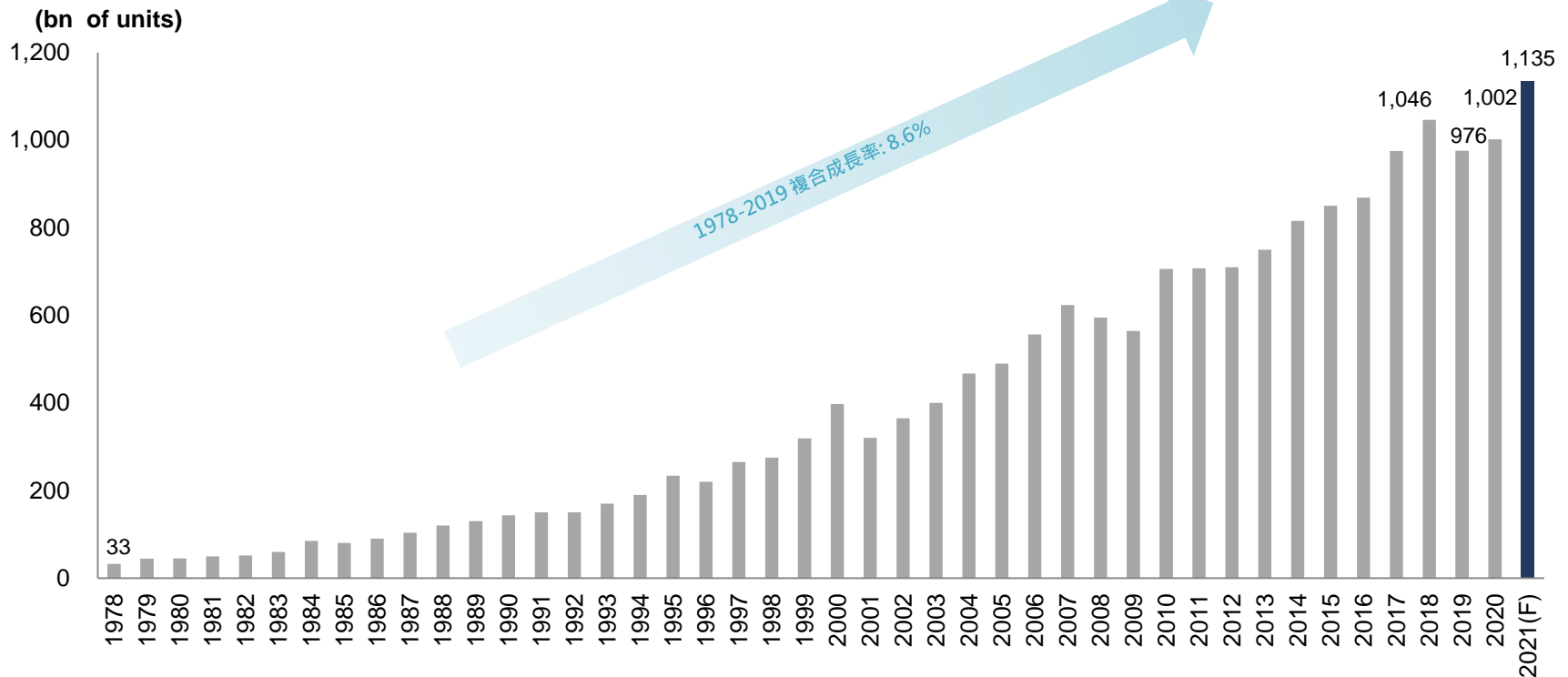
Source: IMF, April 2021



半導體出貨量

- 半導體出貨量2021年可望達1.135兆顆規模，年增率達13%，改寫歷史新高紀錄，這也是半導體出貨量史上第三次達1兆顆以上水準。

半導體歷年出貨量



Source : IC Insights, April 2021

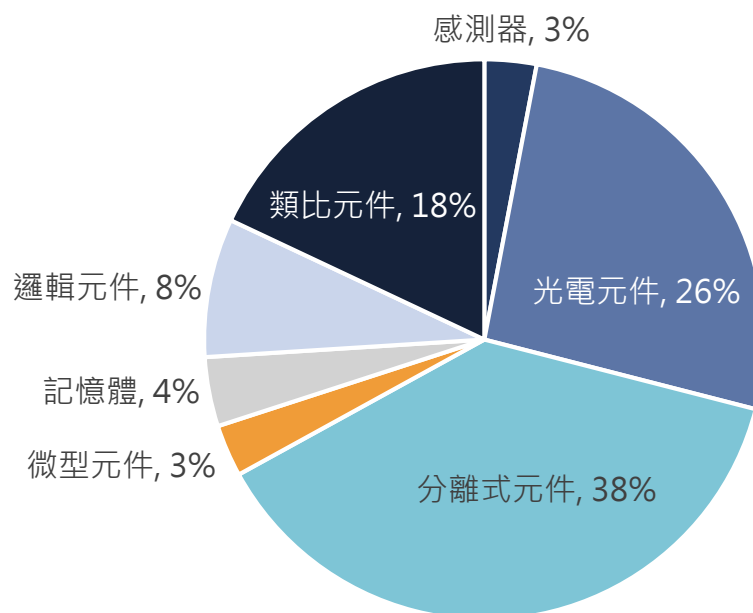
Note: Shipment includes IC, optoelectronics, sensor/actuator, and discrete (O-S-D) device



2021年半導體單位出貨量預估(依應用別)

- 2021年O-S-D設備(含光電元件、感測器、分離式元件) 佔總體半導體出貨量達67%。
- 預測2021年單位出貨量增長最快的產品來自網路和雲端計算系統、非接觸式系統(包括無人自動駕駛)和5G佈建的相關應用。

半導體產品類別出貨量預測 (2021F)



Source : IC Insights, April 2021

Note: Shipment includes IC, optoelectronics, sensor/actuator, and discrete (O-S-D) device

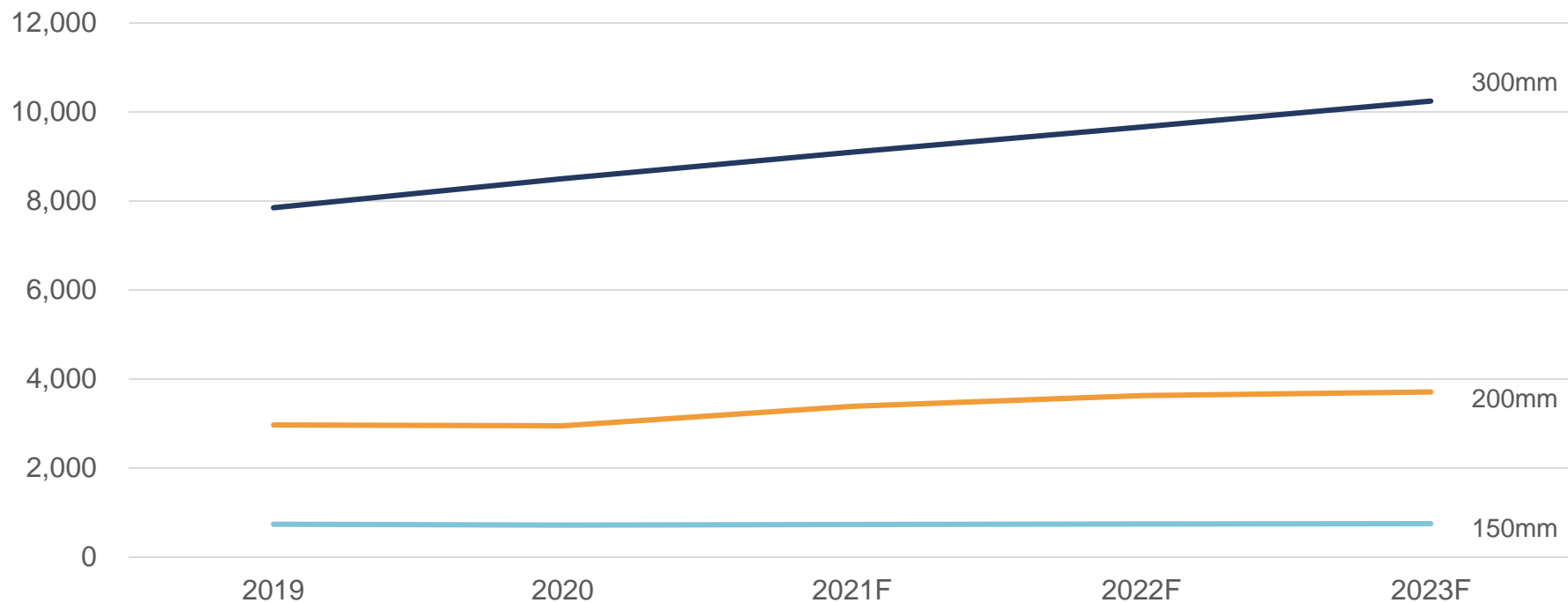


半導體矽晶圓出貨預估(依尺寸別)

➤ 所有尺寸矽晶圓的成長動能皆有望持續到2023年。

半導體矽晶圓出貨面積預估

(單位:百萬平方英吋)



Source: SEMI ORG report + GWC estimates, April 2021



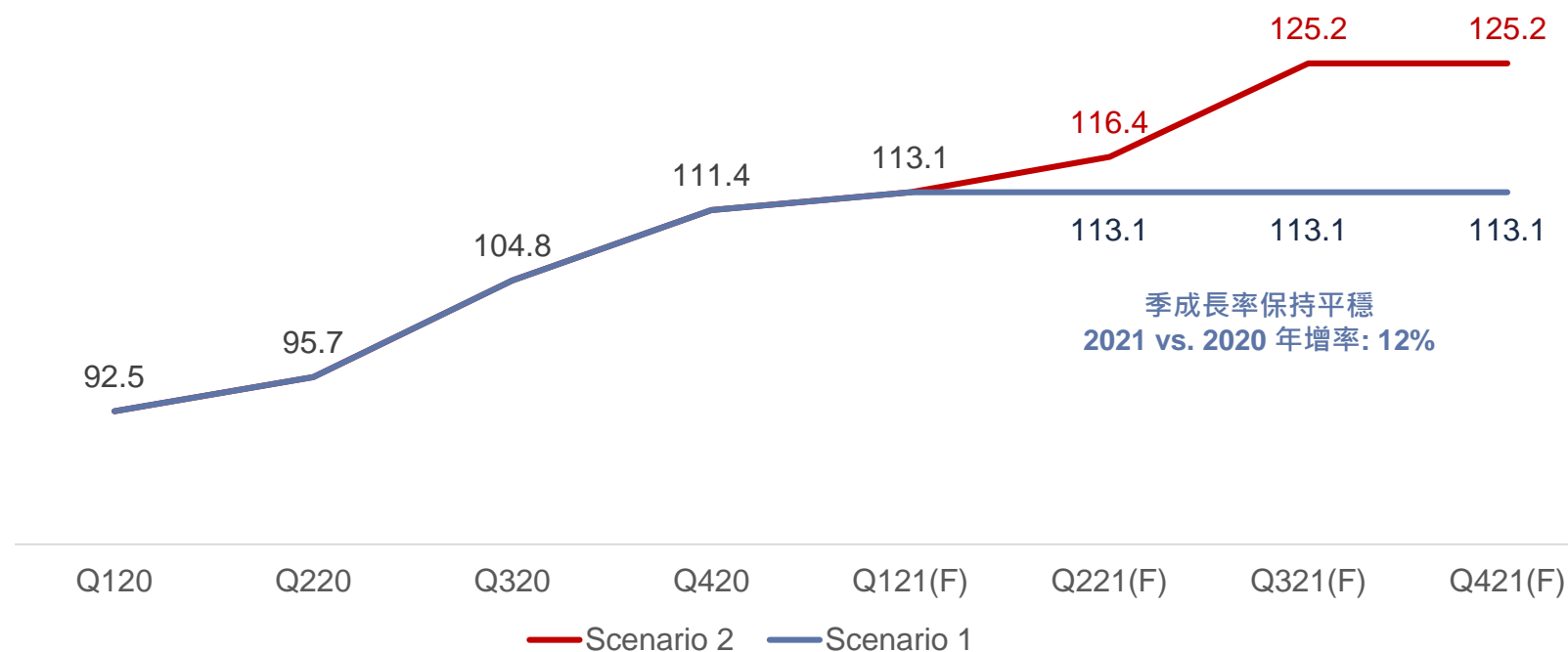
IC 市場成長狀況

- 研究報告預測，IC市場將由12%成長至19%，預期大多數的IC產品如：類比元件、邏輯元件、DRAM等都將持續成長。

IC市場成長率情境預測 (Q221~Q421)

(單位: \$十億)

季成長率增加
2021 vs. 2020 年增率: 19%



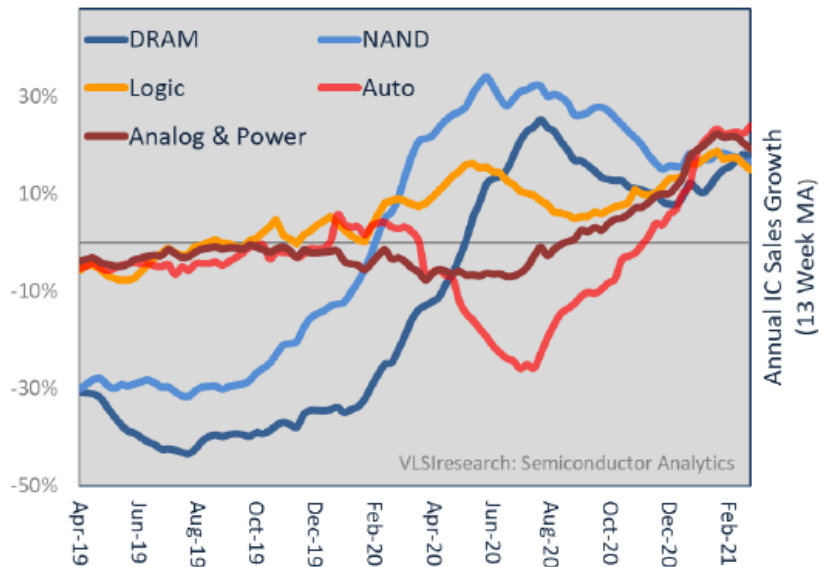
Source: IC Insights, March, 2021



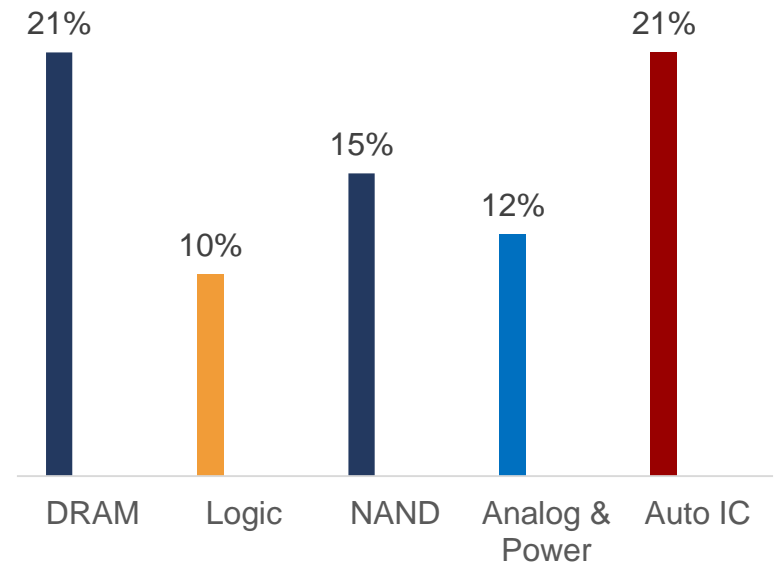
半導體市場營收預估

➤ 調研機構VLSI指出與過去兩年不同，今年所有半導體設備營收成長有望超越10%

半導體營收狀況



2021年成長預測



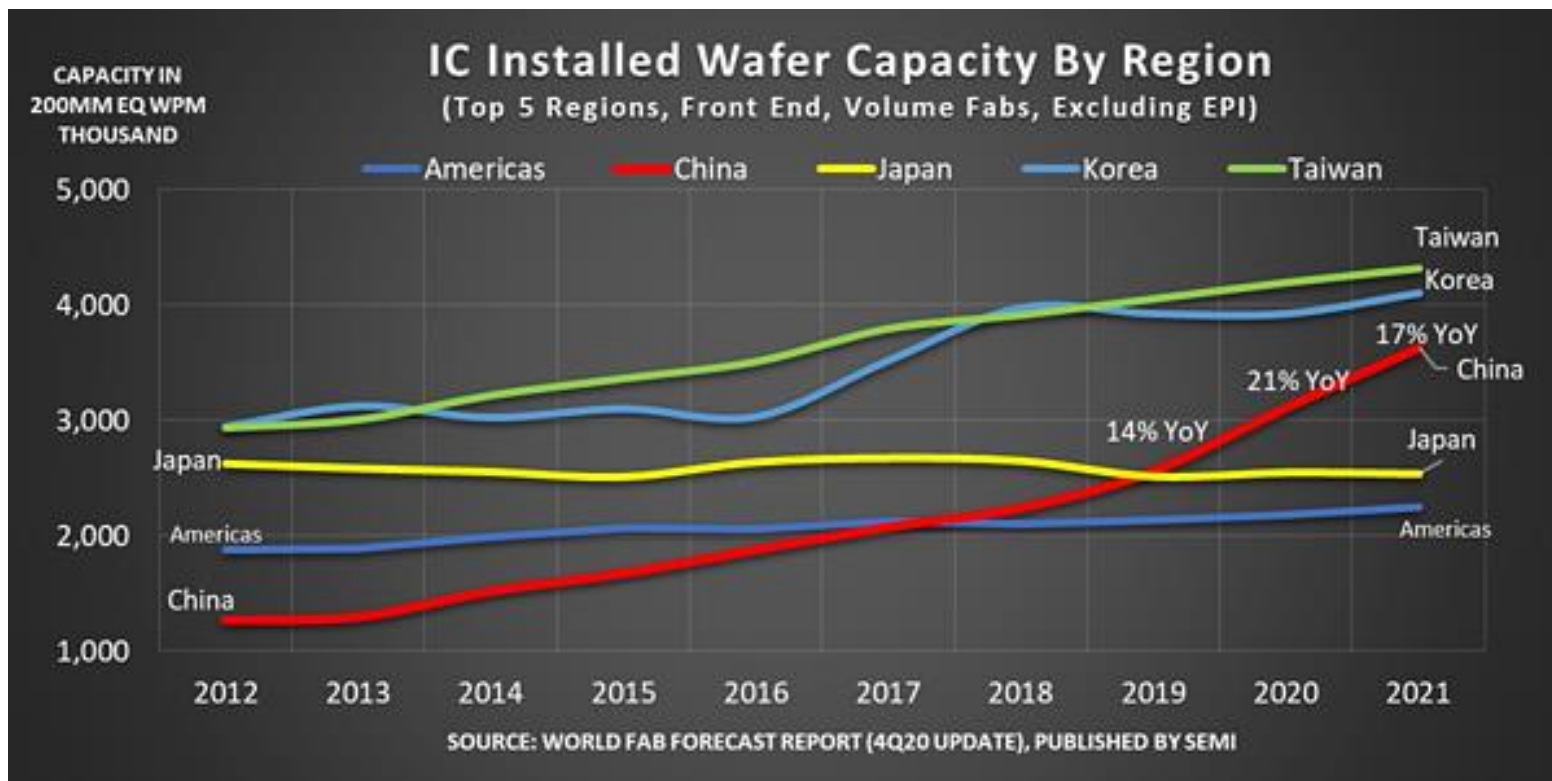
Source: VLSI Research, March 2021



半導體晶圓廠產能(依地區別)

- 據國際半導體組織SEMI指出，中國的晶圓廠產能2019年增長幅度達14%，2020年增長率為21%，預計2021年增長率可達17%。在所有地區中，台灣的同期增長率為3%至4%，位居世界第二。

晶圓安裝量(依地區別)

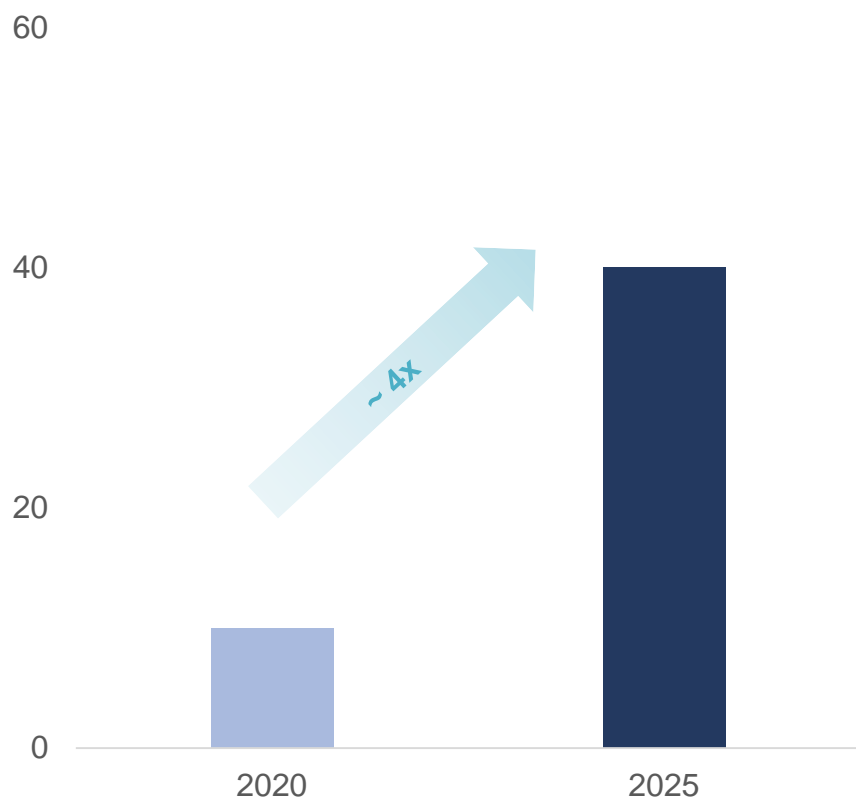


Source: SEMI Org, 4Q20

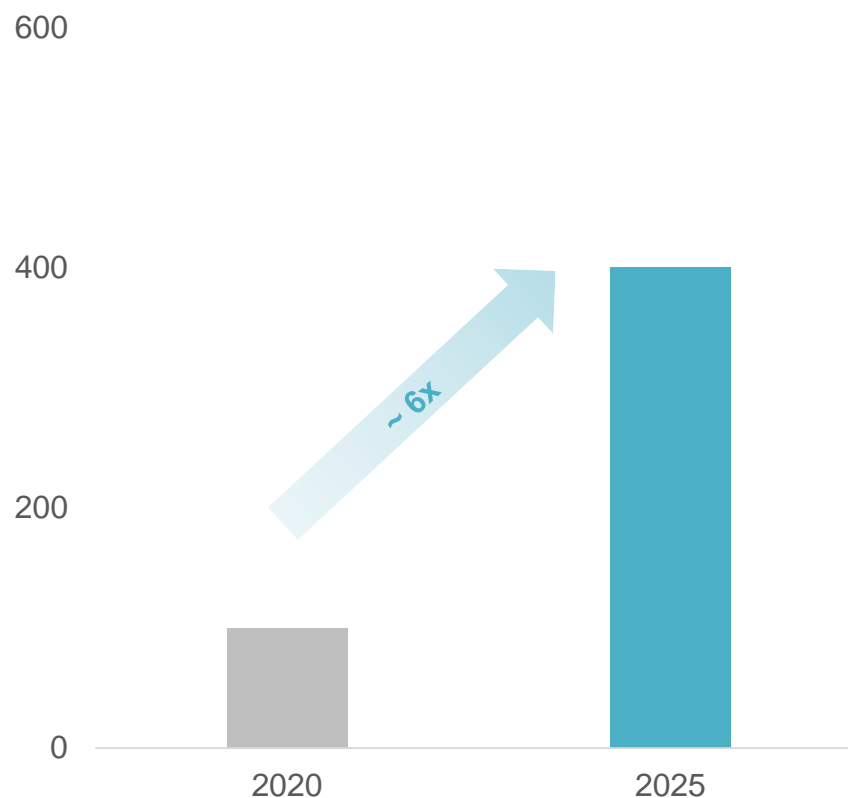
車用半導體: 成長最快的記憶體和儲存市場

- 根據市場資訊，汽車對於記憶體需求將超過其他產業。
- 大多數的汽車記憶體以資訊娛樂系統為主，但自動駕駛會驅動最大的記憶體需求。

車載系統DRAM成長預估範例* (GB)



車載系統NAND成長預估範例* (GB)



Note: Large Sedan E Segment non-Luxury Example
Source: IHS, Micron



5G生態系統正在擴大

➤ 5G的成長動能率持續增加，網絡發展和相關設備的支持加速5G滲透率。

5G發展的關鍵數字

20%

COVID-19發生前6個月，數據傳輸量增長20%

69%

目前已有69%的電信服務商推出智慧型手機的5G商業服務

35億

到2026年5G用戶預計將達到35億

54%

到2026年，使用5G傳輸數據的比例可達54%

Source: Ericsson Mobility Report, November, 2020



營運表現



財務摘要

➤ 2021年第一季度

- 營收 – NTD 14,806 百萬元，無懼逆風，逐季成長
- 毛利率佔營收比例 (35.1%) & EPS(NTD 6.18) – 今年獲利較低的因素如下：
 - ✓ 美國暴風雪
 - ✓ 日本大地震
 - ✓ 蘇伊士運河阻塞使運費上漲
 - ✓ 貨櫃艙位短缺導致緊急調度的運輸成本
 - ✓ 多項原物料成本上漲

Note:

1. Cash = cash and the equivalent + restricted cash

2. FX Rate: NTD:USD = 28.535



財務摘要：2021年第一季 vs. 2020年第一季

(NT\$mn)	Q121	Q120	年成長率
營業收入	14,806	13,515	9.6%
EBITDA* ¹	5,051	5,015	0.7%
EBITDA %	34.1%	37.1%	-3.0%
EBIT	3,544	3,845	-7.8%
營業淨利	3,952	3,805	3.9%
營業淨利 %	26.7%	28.2%	-1.5%
本期淨利	2,690	2,880	-6.6%
本期淨利 %	18.2%	21.3%	-3.1%
每股盈餘	NT\$6.18	NT\$6.62	-NT\$0.44
股東權益報酬率* ² (年化)	24.2%	28.2%	-4.0%
資產報酬率* ³ (年化)	11.3%	12.0%	-0.7%

1. EBITDA = 本期淨利 + 折舊費用 + 攤銷費用 + 利息 + 所得稅

2. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益

3. ROA = ((本期淨利 + 利息 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產)

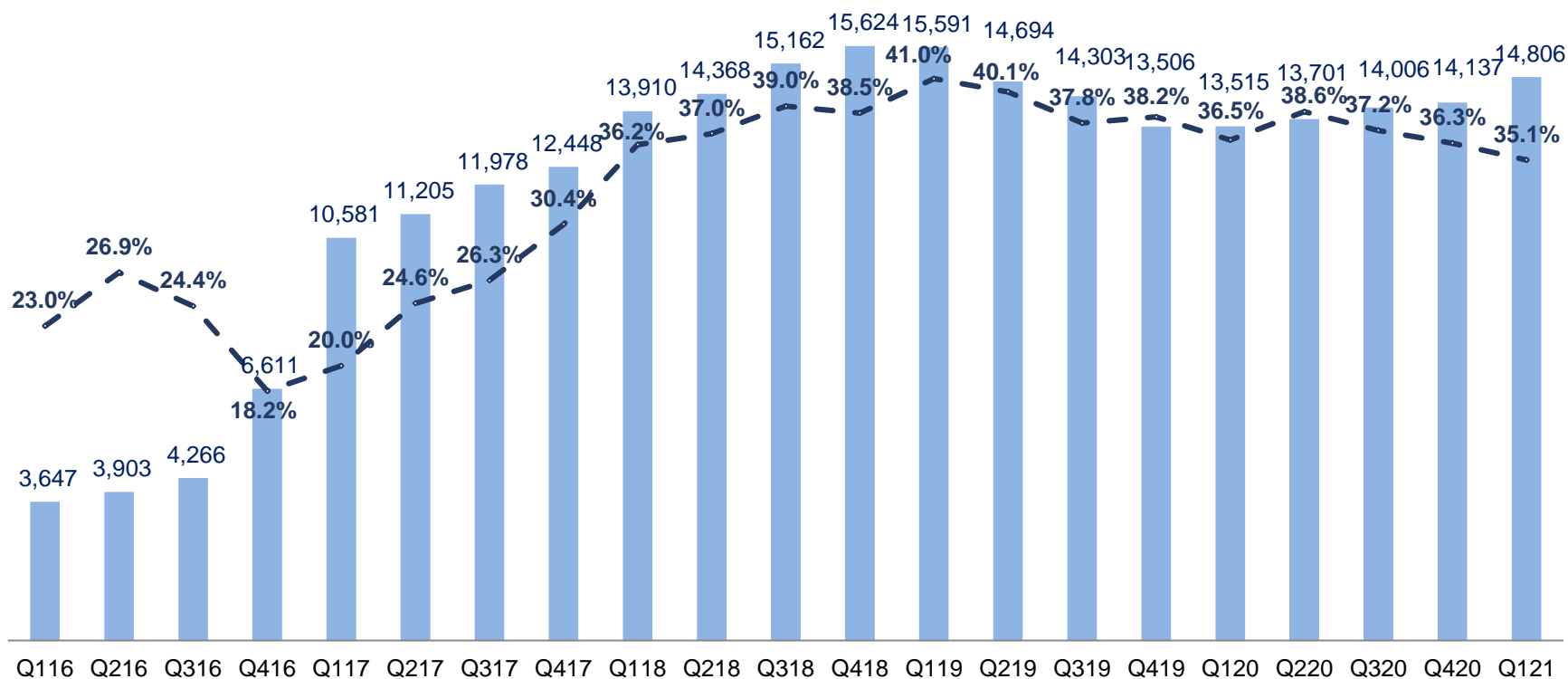


營業收入 & 毛利

營業收入 & 毛利

(NT\$mn)

Revenue GM %

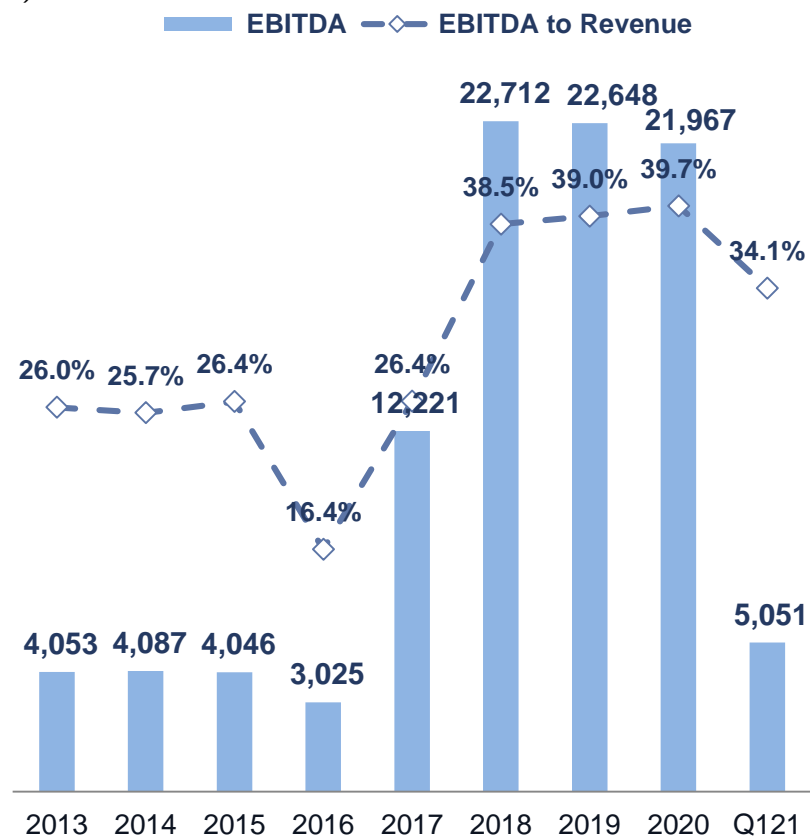




EBITDA & EPS

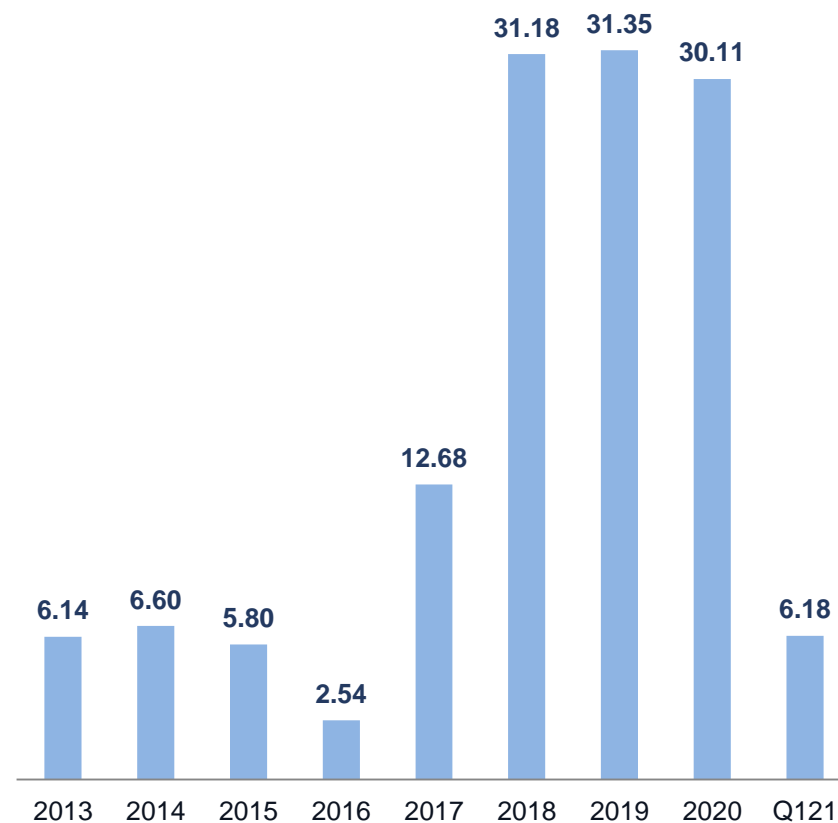
EBITDA

(NT\$m
n)



EPS

(NT\$)





綜合損益表

綜合損益表

(NT\$mn)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1Q21
營業收入	15,570	15,922	15,310	18,427	46,213	59,064	58,094	55,359	14,806
成長率 (%)	-	2.3%	-3.8%	20.4%	150.8%	27.8%	-1.6%	-4.7%	-
營業毛利	3,663	3,728	4,073	4,130	11,808	22,299	22,847	20,568	5,193
營業毛利率 (%)	23.5%	23.4%	26.6%	22.4%	25.6%	37.8%	39.3%	37.2%	35.1%
EBITDA	4,053	4,087	4,046	3,025	12,221	22,712	22,648	21,967	5,051
EBITDA率 (%)	26.0%	25.7%	26.4%	16.4%	26.4%	38.5%	39.0%	39.7%	34.1%
營業淨利	2,194	2,336	2,685	1,378	7,414	17,578	17,897	15,287	3,952
營業淨利率 (%)	14.1%	14.7%	17.5%	7.5%	16.0%	29.8%	30.8%	27.6%	26.7%
稅前淨利	2,204	2,679	2,808	1,344	6,875	18,253	18,554	16,615	3,529
稅前淨利率 (%)	14.2%	16.8%	18.3%	7.3%	14.9%	30.9%	31.9%	30.0%	23.8%
淨利	1,948	2,095	2,044	939	5,278	13,634	13,636	13,104	2,690
淨利率 (%)	12.5%	13.2%	13.4%	5.1%	11.4%	23.1%	23.5%	23.7%	18.2%
EPS (NT\$)	6.14	6.60	5.80	2.54	12.68	31.18	31.35	30.11	6.18

Note:
1. 2016年GWC完成SunEdison半導體(SEMI)的收購後，2016年度之財務報告即包含SEMI，其涵蓋的期間為2016年12月2日至2016年12月31日。
2. 3Q20為累計數



資產負債表

資產負債表

(NT\$mn)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1Q21
資產									
現金及約當現金	1,536	2,685	3,662	5,628	18,794	35,214	32,822	22,439	12,700
應收帳款	3,165	3,694	4,538	7,642	7,869	9,226	8,140	8,037	9,094
存貨	3,291	2,829	3,262	7,307	7,347	7,040	6,849	7,208	6,772
不動產、廠房及設備	9,796	8,972	9,361	31,036	28,202	30,887	34,697	37,111	35,331
其他資產	3,286	3,204	2,994	8,948	8,020	7,455	14,078	20,056	32,684
資產總計	21,074	21,385	23,816	60,560	70,232	89,822	96,586	94,852	96,581
負債									
短期借款	1,302	2,069	696	12,982	10,738	5,042	9,886	9,871	15,445
應付帳款	1,816	1,789	1,383	5,126	4,269	4,870	3,837	3,895	4,075
長期借款	--	--	--	14,367	3,663	430	--	--	--
其他負債	4,821	4,325	5,012	12,267	17,508	36,324	37,790	36,930	32,314
負債總計	7,939	8,184	7,091	44,742	36,178	46,666	51,513	50,697	51,834
權益總計	13,135	13,201	16,725	15,819	34,054	43,156	45,073	44,155	44,747

Note:

- 2016年GWC完成SunEdison Semiconductor (SEMI)的收購後，2016年度之財務報告即包含SEMI，其涵蓋的期間為2016年12月2日至2016年12月31日。
- 應收帳款包括關係人。
- 應付帳款包含關係人。



Q&A



Thank You
